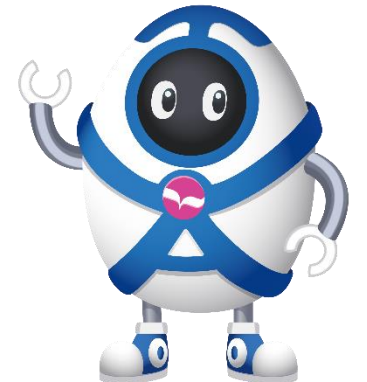


2026年3月期 決算説明資料

2026年5月11日

[Click here for the English Ver](#)



1. 2026年3月期 実績

2. 2027年3月期 予想

3. TOPICS

1. 2026年3月期 実績

2. 2027年3月期 予想

3. TOPICS

2026年3月期 サマリー

受注高

595.6 億円

(前年同期比 +25.6%)

売上高

543.6 億円

(前年同期比 +1.7%)

営業利益

69.1 億円

(前年同期比 ▲22.1%)

経常利益

69.4 億円

(前年同期比 ▲26.1%)

当期純利益

45.9 億円

(前年同期比 ▲43.4%)

▶ 受注高

- ・ AI・データセンター向けを中心に2Q以降好調に推移し、過去2番目の受注高を記録。
- ・ メモリや先端パッケージ向け投資の増加によりコンプレッション装置・金型の受注は過去最高を記録。

▶ 売上高

- ・ 受注同様メモリや先端パッケージ向けなどAI・データセンター向けが好調で過去最高の売上高を記録。
- ・ メモリ向け投資の増加により、シングュレーション装置の売上高が大幅に増加。

▶ 利益

- ・ 売上高は増加したものの、製品ミックス変動や初回納入に伴う追加コストの影響により減益。

2026年3月期 連結業績結果

(単位：億円)

	2025/3期 実績	2026/3期 実績	前期比	2026/3期 修正予想	予想比
売上高	534.7	543.6	+ 8.8 (+ 1.7%)	545.0	▲ 1.3 (▲ 0.2%)
営業利益	88.8	69.1	▲ 19.6 (▲ 22.1%)	70.0	▲ 0.8 (▲ 1.2%)
営業利益率	16.6%	12.7%	▲ 3.9pt	12.8%	▲ 0.1pt
経常利益	94.0	69.4	▲ 24.5 (▲ 26.1%)	70.0	▲ 0.5 (▲ 0.8%)
当期純利益	81.2	45.9	▲ 35.2 (▲ 43.4%)	49.5	▲ 3.5 (▲ 7.2%)

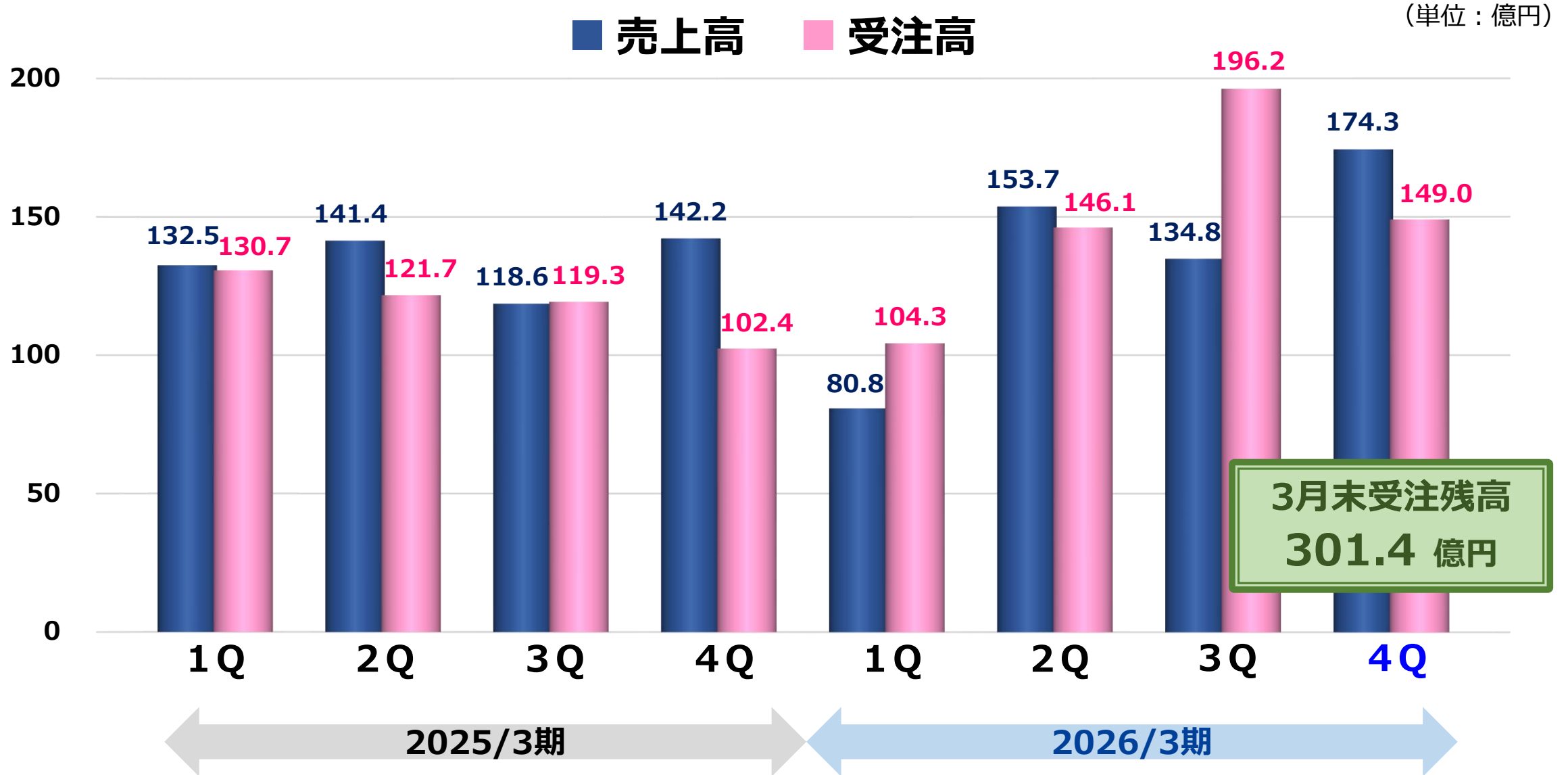
※当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

2026年3月期 セグメント別売上高

(単位：億円)

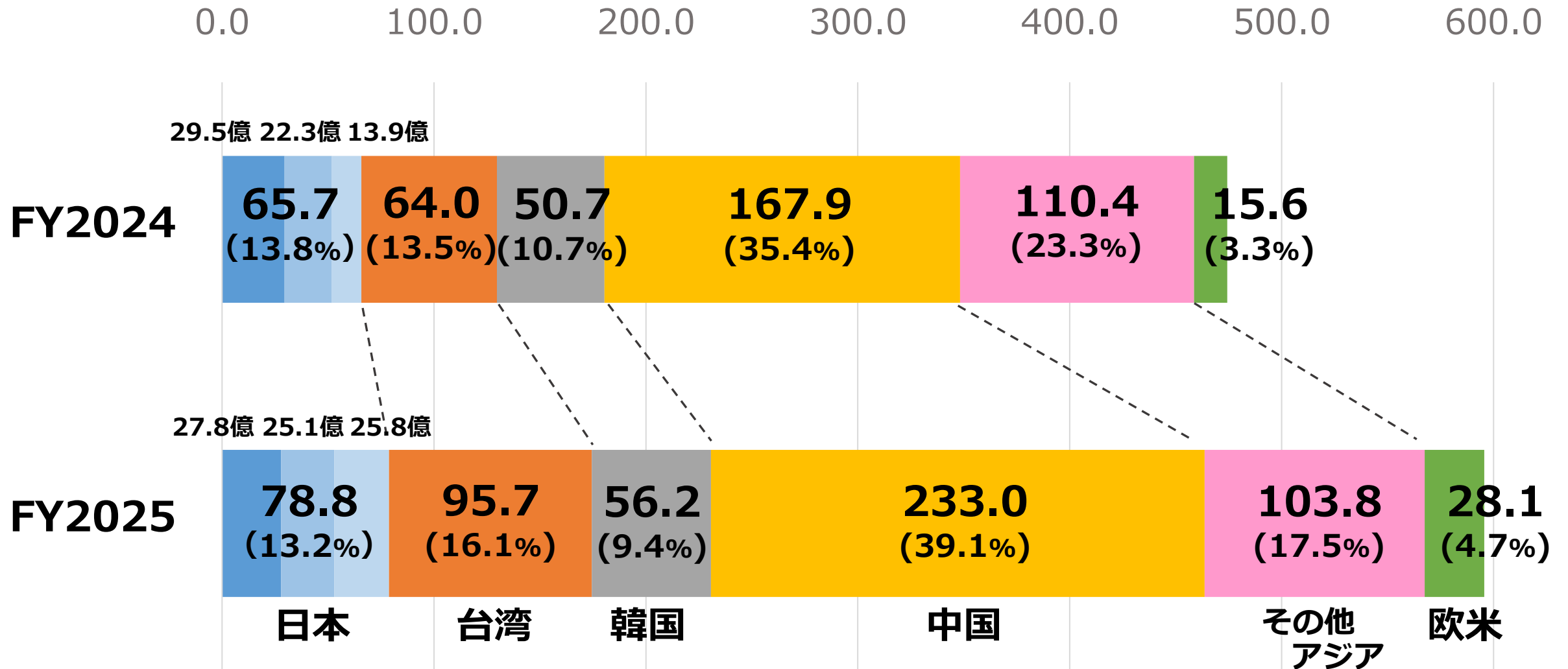
	2025/3期 実績	2026/3期 実績	前期比	2026/3期 修正予想	予想比
売上高	534.7	543.6	+ 8.8 (+ 1.7%)	545.0	▲ 1.3 (▲ 0.2%)
半導体事業	395.3	403.9	+ 8.6 (+ 2.2%)	399.8	+ 4.1 (+ 1.0%)
メディカル デバイス事業	22.6	24.8	+ 2.2 (+ 9.9%)	25.0	▲ 0.1 (▲ 0.7%)
新事業	94.2	94.7	+ 0.5 (+ 0.6%)	100.2	▲ 5.3 (▲ 5.4%)
レーザ事業	22.6	20.0	▲ 2.5 (▲ 11.0%)	20.0	+ 0.0 (+ 0.4%)

受注・売上高の推移



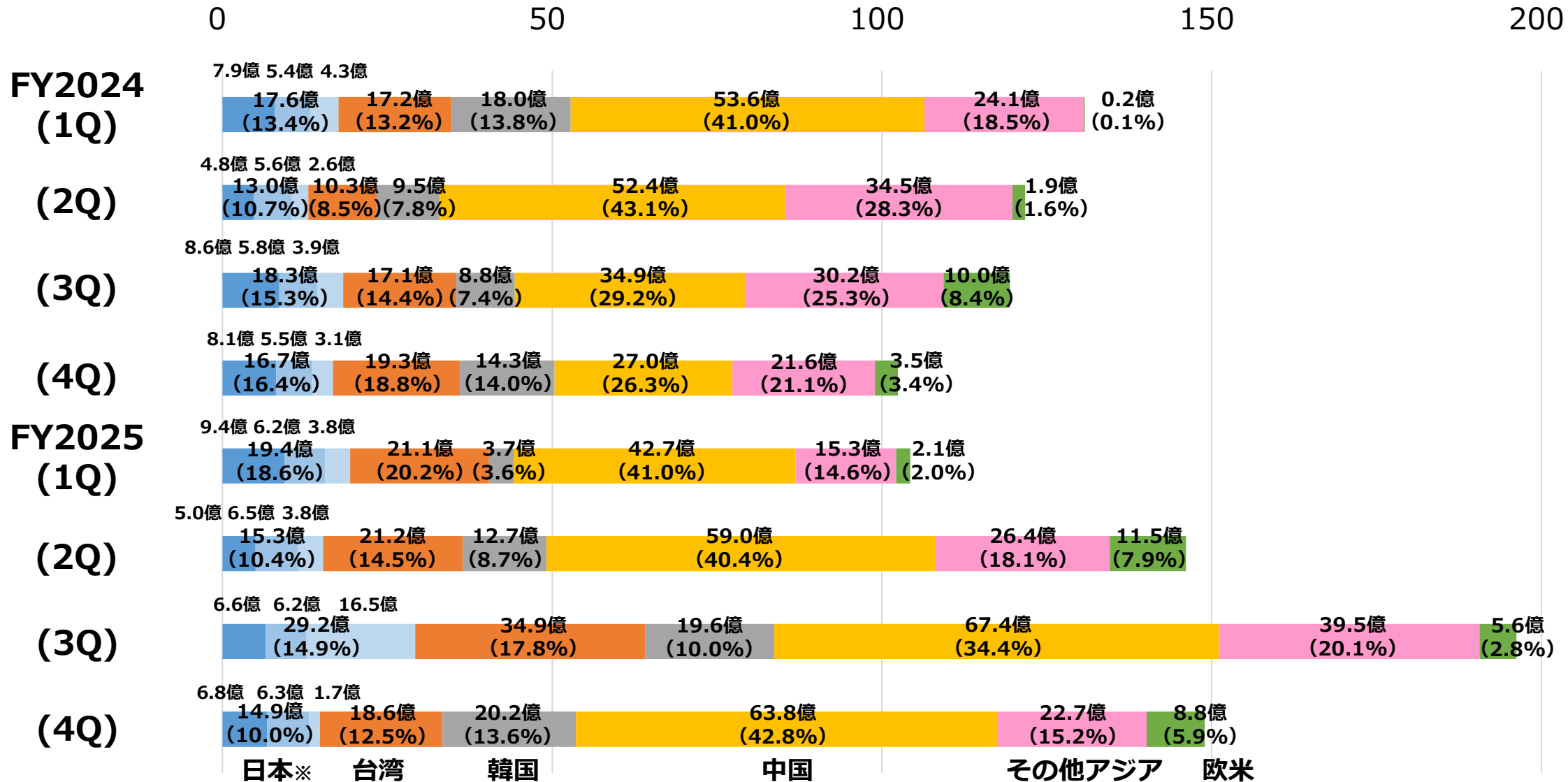
地域別受注構成比率（仕向地ベース）

（単位：億円）



地域別受注構成比率推移（仕向地ベース）

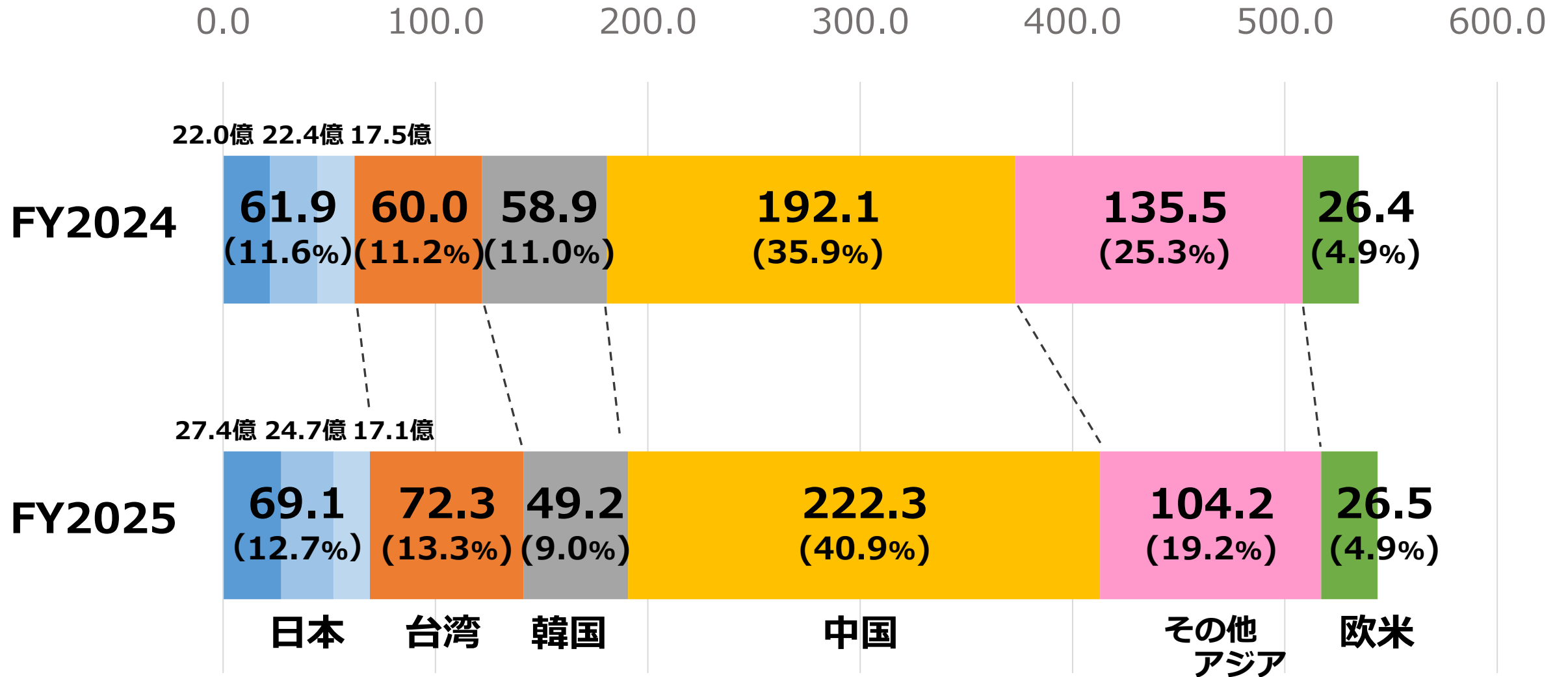
（単位：億円）



※日本は左から半導体事業（新事業含む）、メディカルデバイス事業、レーザ事業

地域別売上構成比率（仕向地ベース）

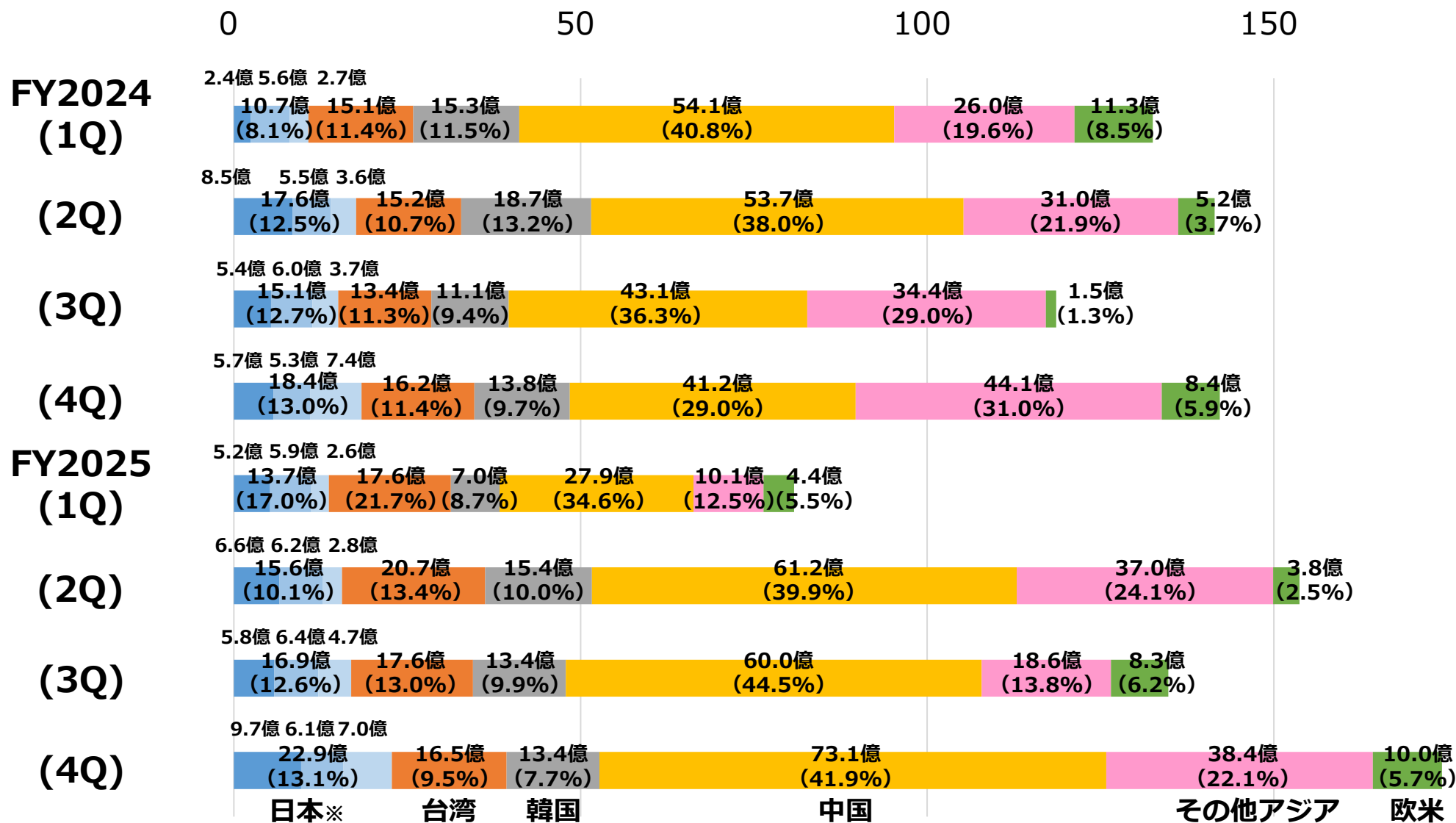
（単位：億円）



※日本は左から半導体事業（新事業含む）、メディカルデバイス事業、レーザ事業

地域別売上構成比率推移（仕向地ベース）

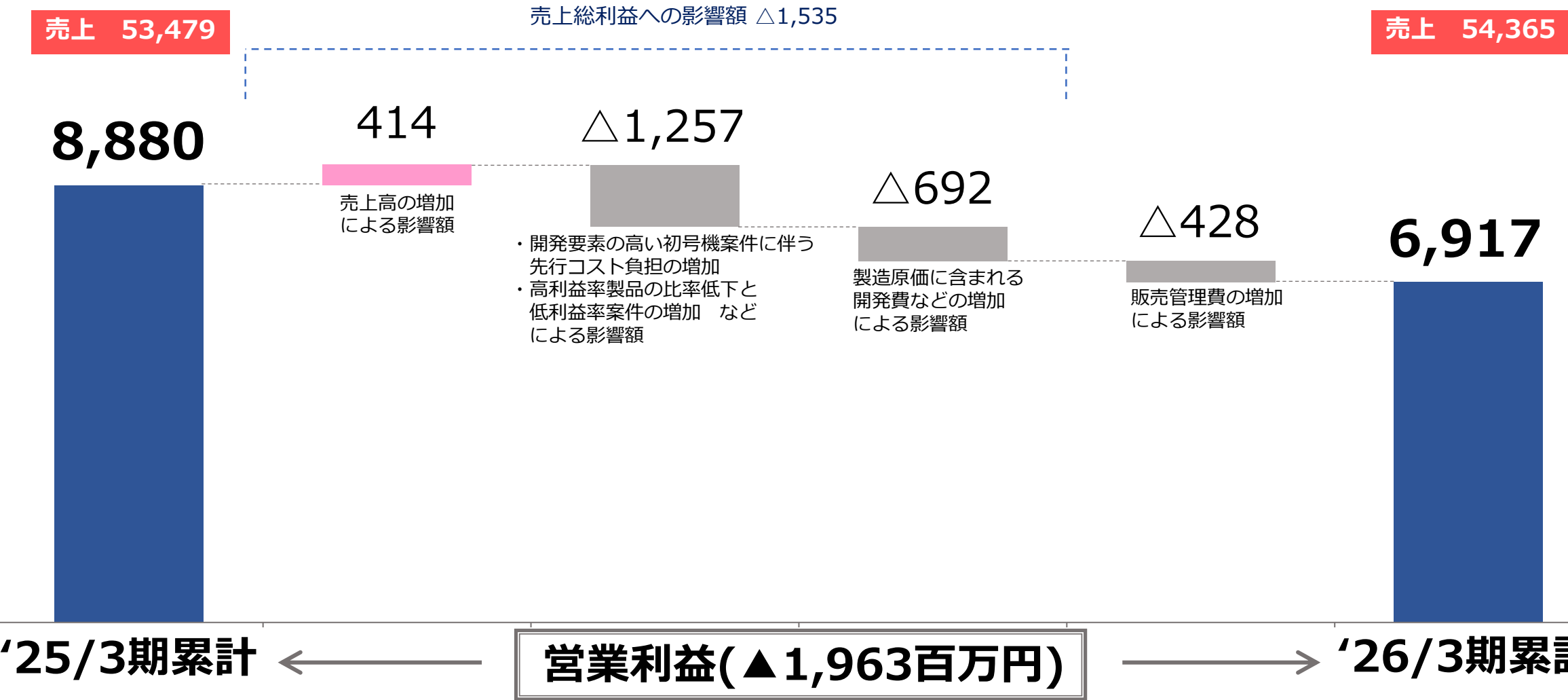
（単位：億円）



※日本は左から半導体事業（新事業含む）、メディカルデバイス事業、レーザ事業

2026年3月期累計 連結営業利益 増減要因分析（対前年同期比）

（単位：百万円）



※百万円未満切り捨て

1. 2026年3月期 実績

2. 2027年3月期 予想

3. TOPICS

2027年3月期 通期 連結業績予想

(単位：億円)

	2026/3期 実績	2027/3期 予想	増減額	前期比
売上高	543.6	640.0	+ 96.3	+ 17.7%
営業利益	69.1	102.4	+ 33.2	+ 48.0%
営業利益率	12.7%	16.0%	+ 3.3 _{pt}	-
経常利益	69.4	102.4	+ 32.9	+ 47.4%
当期純利益	45.9	70.0	+ 24.0	+ 52.4%

※当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

2027年3月期 セグメント別売上予想

(単位：億円)

	2026/3期 実績	2027/3期 予想	増減額	前期比
売上高	543.6	640.0	+ 96.3	+ 17.7%
半導体事業	403.9	484.3	+ 80.3	+ 19.9%
メディカル デバイス事業	24.8	25.5	+ 0.6	+ 2.5%
新事業	94.7	97.7	+ 2.9	+ 3.1%
レーザ事業	20.0	32.5	+ 12.4	+ 61.9%

設備投資・配当予想

	2026/3期 実績	2027/3期 予想
設備投資	41.9億円	55.0億円
配 当	20.0円	24.0円

▶ 主な設備投資予定

- ・ スマートファクトリー関連
- ・ 各工場における新規生産設備導入や更新による生産能力UP
- ・ ラボ機能強化
- ・ DX投資

◆ その他M&A等は積極的に実施

※配当方針「安定・継続配当」に基づき、4.0円増配の24.0円を計画しています。

市場見通し

受注

- ▶ AI・データセンター関連の投資が引き続き牽引。
- ▶ 先端パッケージ向けPLPの量産向け投資の開始を見込む。

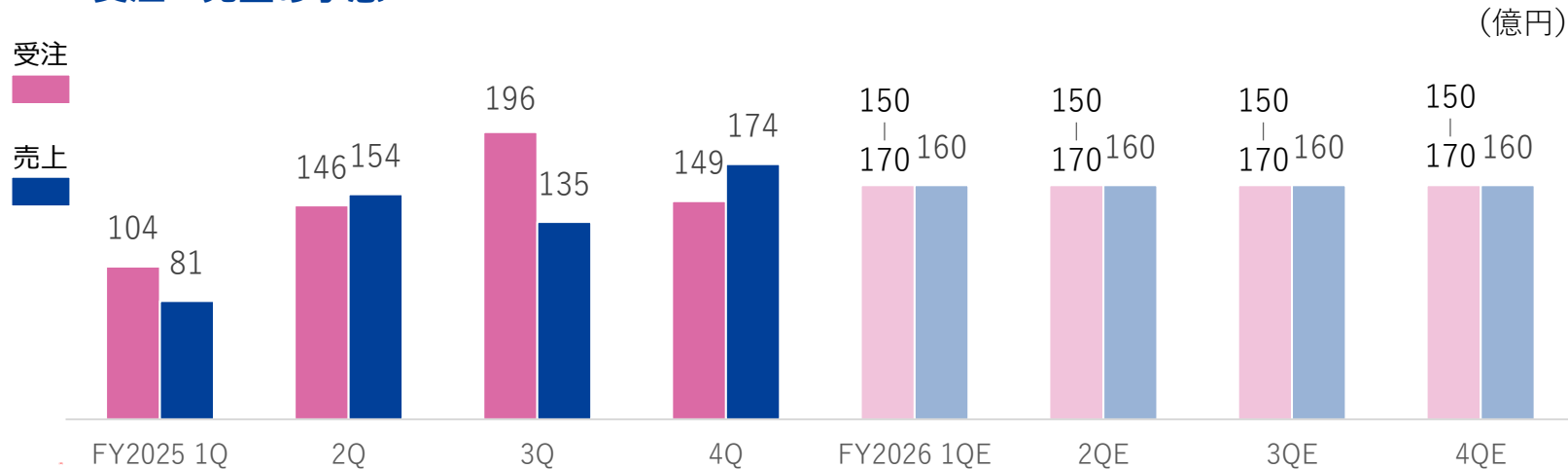
売上

- ▶ 受注残高や足元の受注水準から安定的な売上高を予想。

利益

- ▶ 売上高の増加に伴い、利益率も前期比で改善を予想。
- ▶ WLPにおける、市場ポジション強化を優先し、利益率は段階的な改善を見込む。

受注・売上の予想



受注高予想

1Q 2Q
150-170億円 150-170億円

3Q 4Q
150-170億円 150-170億円

損益予想

売上高	640.0億円
営業利益	102.4億円
経常利益	102.4億円
当期利益	70.0億円

1. 2026年3月期 実績

2. 2027年3月期 予想

3. TOPICS

主な地域の受注動向予想

中国

- ▶ EV向けやパワーモジュール国産化投資が堅調
- ▶ メモリ需給逼迫を背景に関連投資も継続

台湾

- ▶ AIサーバー需要増を受けOSATでの生産が拡大
- ▶ PLP量産投資が下期以降に立ち上がる

韓国

- ▶ 顧客の工場スペース制約によりHBM投資は下期以降
- ▶ 足元では汎用メモリ投資が増加

その他 アジア

- ▶ AI・データセンター向けに需要は底堅い
- ▶ インドで量産立ち上げにともない投資が拡大

HBM・先端パッケージ動向

市場環境

- 半導体市場はAI用途（HBM・GPU・AIアクセラレータなど）が成長を牽引。

HBM

- 高い需要を背景に、メモリ各社はHBM量産投資を強化。
- コストや技術的な課題からMUF技術による生産が継続。

先端パッケージ

- カスタムASIC向けではOSATによる先端パッケージ向けの投資が増加。
- 生産キャパ拡大、生産効率UPに向けてPLP投資の増加を見込む。

第4次モールドディング革命 ～INNOMS～

半導体量産コストを“半分”に

「第4次モールドディング革命」として新たなスタンダードへ！

コンセプト

✓ 低コスト ✓ 大量生産 ✓ 環境負荷低減

★ 新製品の特長

- ① 量産コスト約50%削減
- ② 1台当たりの生産性2倍
- ③ 設置面積約40%削減
- ④ 消費電力約50%、消耗品材料約25%削減
- ⑤ 幅広いパッケージに対応（メモリ、ロジック、QFN、RFモジュール等）



T O W A ビ ジ ャ ン 2 0 3 2

「変革で世界の頂へ」



《本資料に関するお問合せ》TOWA株式会社 企画部

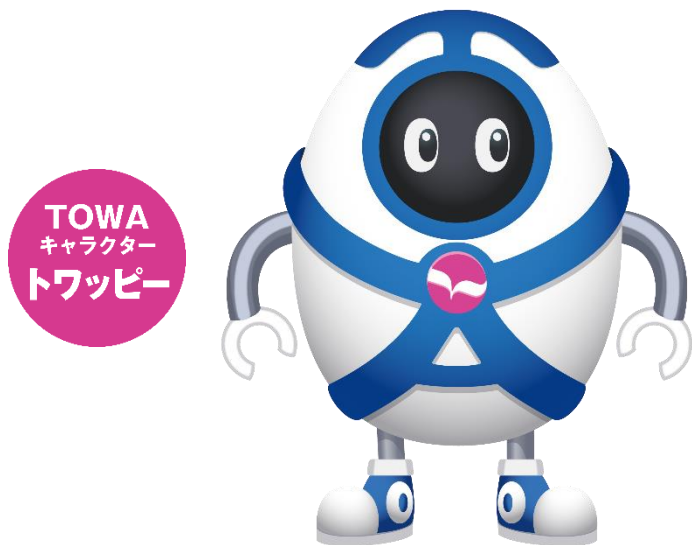
〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5番地 Tel : 075-692-0251

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承願います。

参考資料



会社概要



トワッピーのプロフィール

- ① 名前：「トワッピー」
- ② 名前の由来：
TOWAから世界にハッピーを届ける。
- ③ 好きな言葉：「チャレンジ！」

会社名

TOWA株式会社

事業内容

半導体事業、医療デバイス事業、
新事業、レーザ加工装置事業

所在地

京都市南区上鳥羽上調子町5番地

設立

1979年4月

代表取締役会長

岡田 博和

取締役社長執行役員

三浦 宗男

従業員数

2,211名（2026年3月末時点/連結）

資本金

89億円

証券コード

6315

事業内容

新事業

- ・TSS
(トータルソリューションサービス)
- ・精密加工用工具、受託加工
- ・微細加工
- ・コーティング



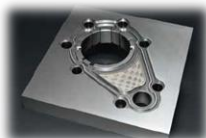
改造・修理
予防保全



微細加工技術



工具 (エンドミル)



受託加工

レーザー加工装置事業

- ・レーザトリマ
- ・ウェハーマーカ
- ・レーザ溶接機



レーザトリミング装置
Model SL432R



ウェハーマーキング装置
Model SL473GS3

半導体事業

- ・半導体製造用精密金型
- ・半導体製造用モールドイング装置
- ・半導体製造用シンギュレーション装置



トランスファ金型



モールドイング装置
Model PMC2030-D



コンプレッション金型



モールドイング装置
Model CPM1080

メディカルデバイス事業

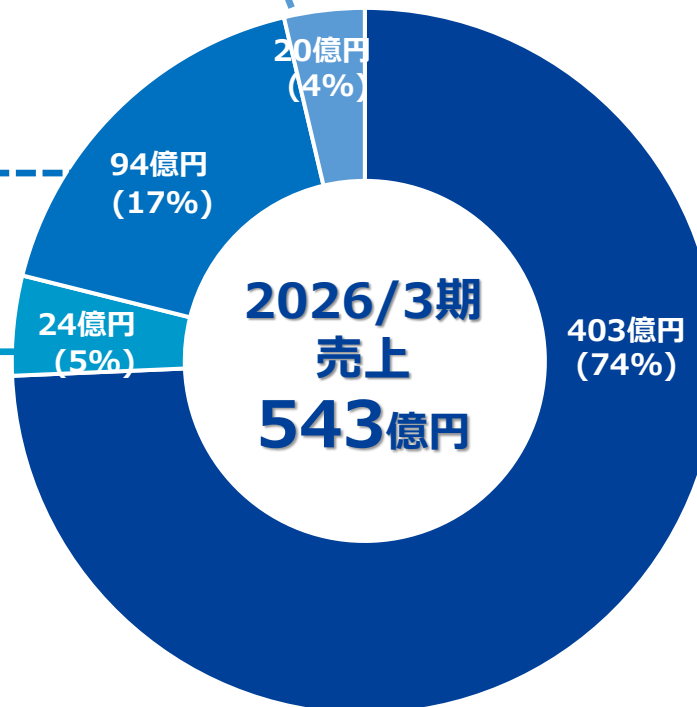
- ・ファインプラスチック成形品
- ・医療機器



点滴用部品

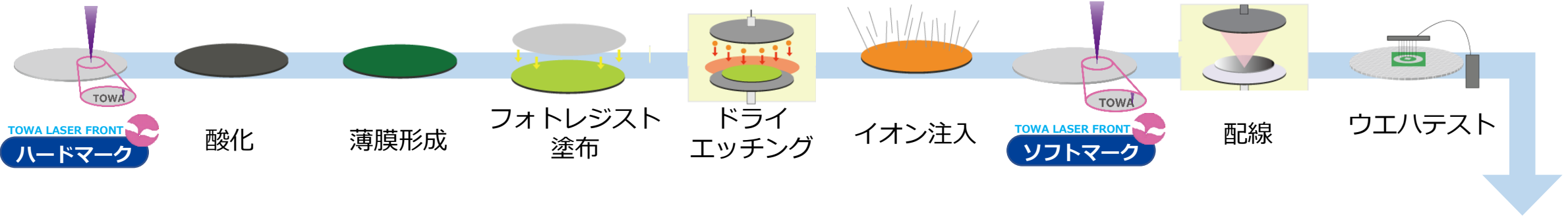


注射器用部品



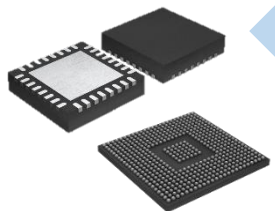
半導体が出来るまで

前工程



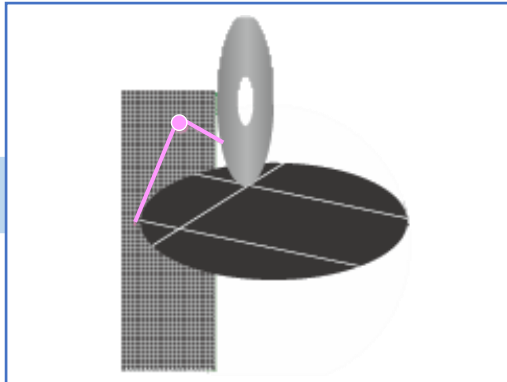
製品検査や
信頼性試験を
経て・・・

**半導体
完成！**



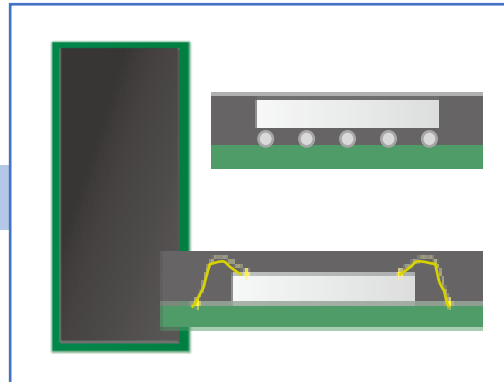
TOWA

シンギュレーション



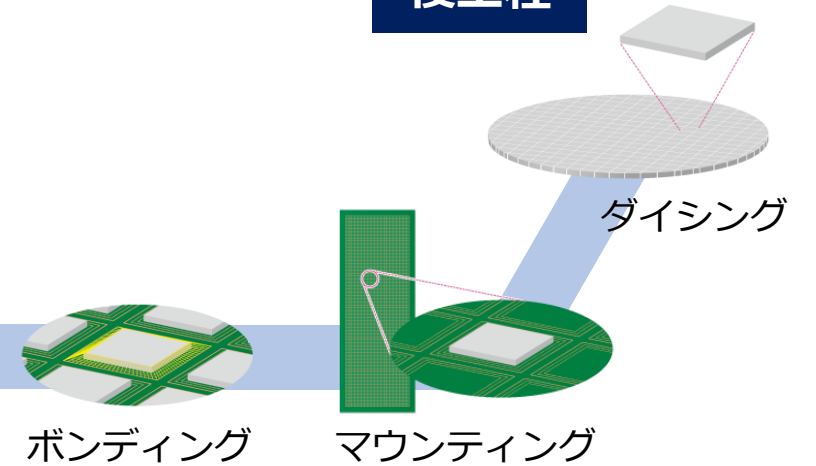
フレームから個々の製品を
切り離します。

モールドイング

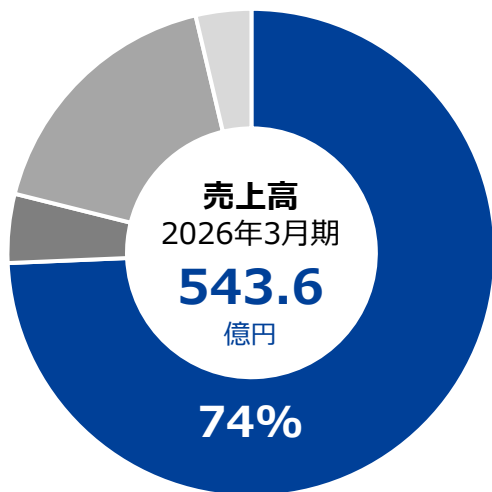


チップを樹脂で封止します。

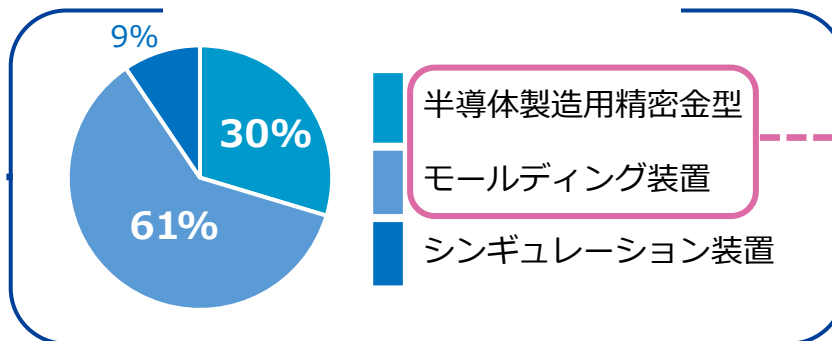
後工程



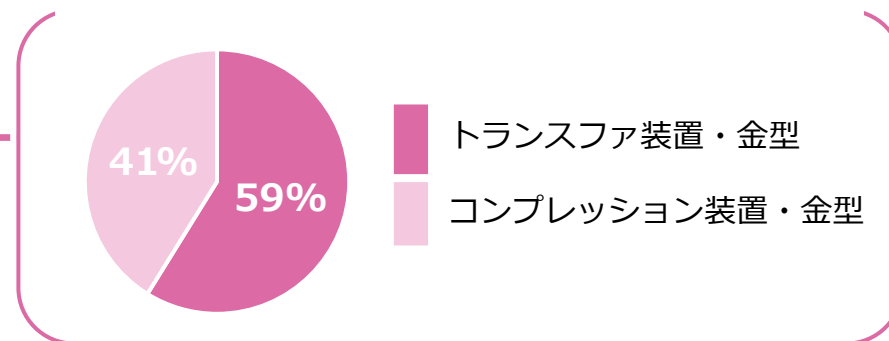
半導体事業

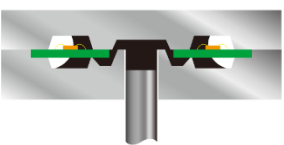

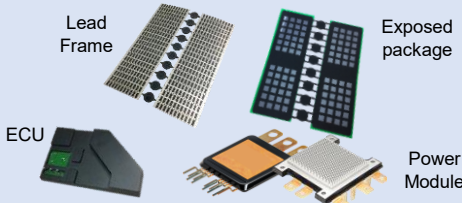
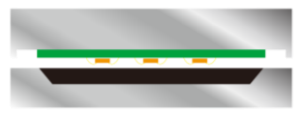
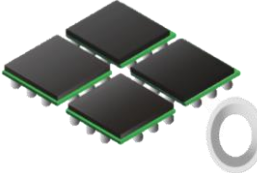


半導体事業 403.9億円



モールドイング装置・金型 364.6億円



モールドイング		シングュレーション
<h3>トランスファ成形</h3> <p>ポット内で溶融した樹脂をキャビティに充填し硬化させる成形手法</p>   <p>トランスファ装置</p>  <p>Lead Frame ECU Exposed package Power Module</p> <p>Work size (Max.): 100×300mm</p>	<h3>コンプレッション成形</h3> <p>金型に直接樹脂を入れ、溶融した後にワークを浸し入れる成形手法</p>   <p>コンプレッション装置</p>  <p>MAP BGA/QFN/HS BGA WLP/PLP</p> <p>Work size (Max.): 660×620mm</p>	<p>樹脂で封止された製品を個片化・収納する工程</p>   <p>シングュレーション装置</p>  <p>Small package Thicker package Substrate</p> <p>Package size (Min.): 1×1 mm</p>

新事業

「新たな市場」創造と事業化へのチャレンジ

TSS事業

(トータルソリューションサービス)

当社半導体製造装置のアフターサービスや改造・修理、中古機の販売までトータルで提案



世界のモールドプロセスをTOWAに！！

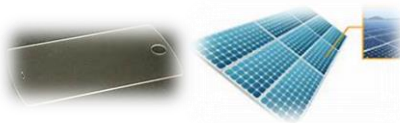
- LEプログラム
(ライフエクステンション)
- 中古機販売
- 予防保全 (年間契約)
- 部品供給
- トレーニングセンター

コーティング

TOWAオリジナルの金型表面処理技術を医療や家庭用品等に応用展開



打錠分野への普及率向上



ガラス製品への普及率向上

ナノテク

超精密金型加工で培った超精密・微細加工技術を医療、自動車分野等に応用展開



細胞培養分野における商品開発



HUD(ヘッドアップディスプレイ)用レンズの開発



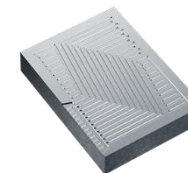
空中映像素子レンズの開発

ツーリング

金型製造メーカーのノウハウが蓄積された自社開発の工具を販売



CBN・超硬エンドミル



受託加工



3Dプリンタと自社製工具の融合

メディカルデバイス事業

会社名	株式会社バンディック
事業内容	医療用プラスチック成形品の製造 医療機器の組立
所在地	山梨県韮崎市龍岡町下條南割596の146
設立	1983年11月18日

代表取締役社長	寺内 利浩
従業員数	100名（2026年3月末時点）

主な製品

医療用プラスチック成形品



超精密金型技術と独自技術による プラスチック成形プロセス



クリーンルーム内で組立、生産

レーザ加工装置事業

会社名	TOWAレーザーフロント株式会社
事業内容	レーザ及びレーザ加工装置の開発・設計・製造・販売・保守
所在地	神奈川県相模原市中央区下九沢1120番地
株式取得日	2018年8月1日

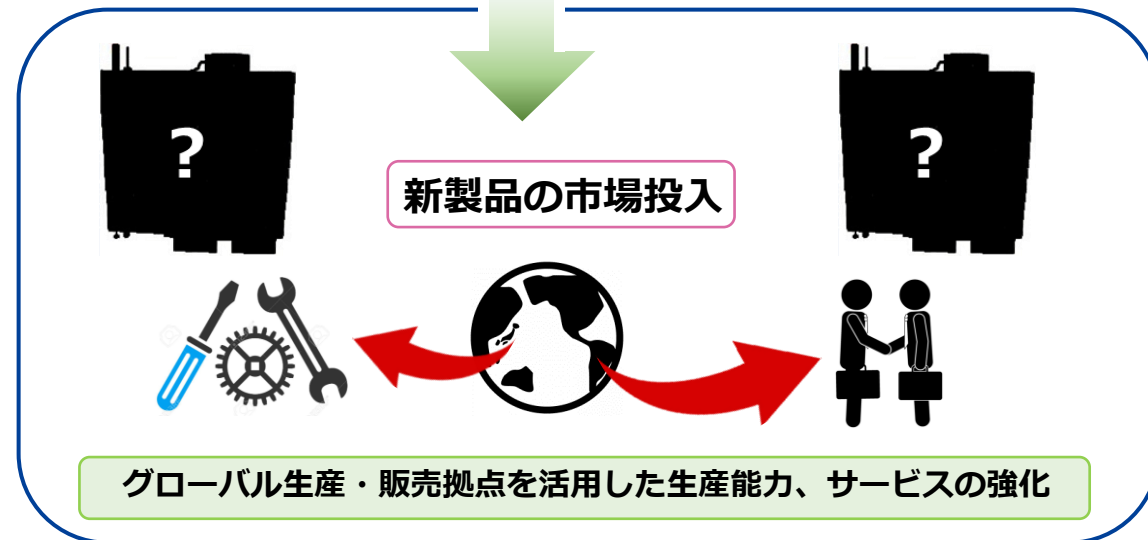
代表取締役社長	岩井 雅浩
従業員数	105名（2026年3月末時点）

主な製品

レーザトリマ	ウェハマーカ	レーザ溶接機
		

レーザ関連技術と半導体製造の後工程技術を融合し、新たな市場へ

TOWA X LASERFRONT



生産拠点

●TOWA

●グループ会社



韓国

●TOWA韓国株式会社

»半導体製造装置、精密金型、部品の製造



●TOWAファイン株式会社

»ブレードの製造



中国

●TOWA半導体設備(蘇州)有限公司

»半導体製造装置、精密金型の製造



●東和半導体設備(南通)有限公司

»半導体製造装置、精密金型の製造



マレーシア

●TOWAM Sdn. Bhd. ●TOWA TOOL Sdn. Bhd.

»半導体製造装置の製造



»半導体製造用金型の製造



京都

●本社・工場(京都市)

»半導体製造装置、精密金型の開発・製造



京都

●京都東事業所(宇治田原町)

»半導体製造用金型の製造



佐賀県(鳥栖市)

●九州事業所

»半導体製造用金型の製造



日本

山梨県(韮崎市)

●株式会社バンディック

»ファインプラスチック成形品の製造

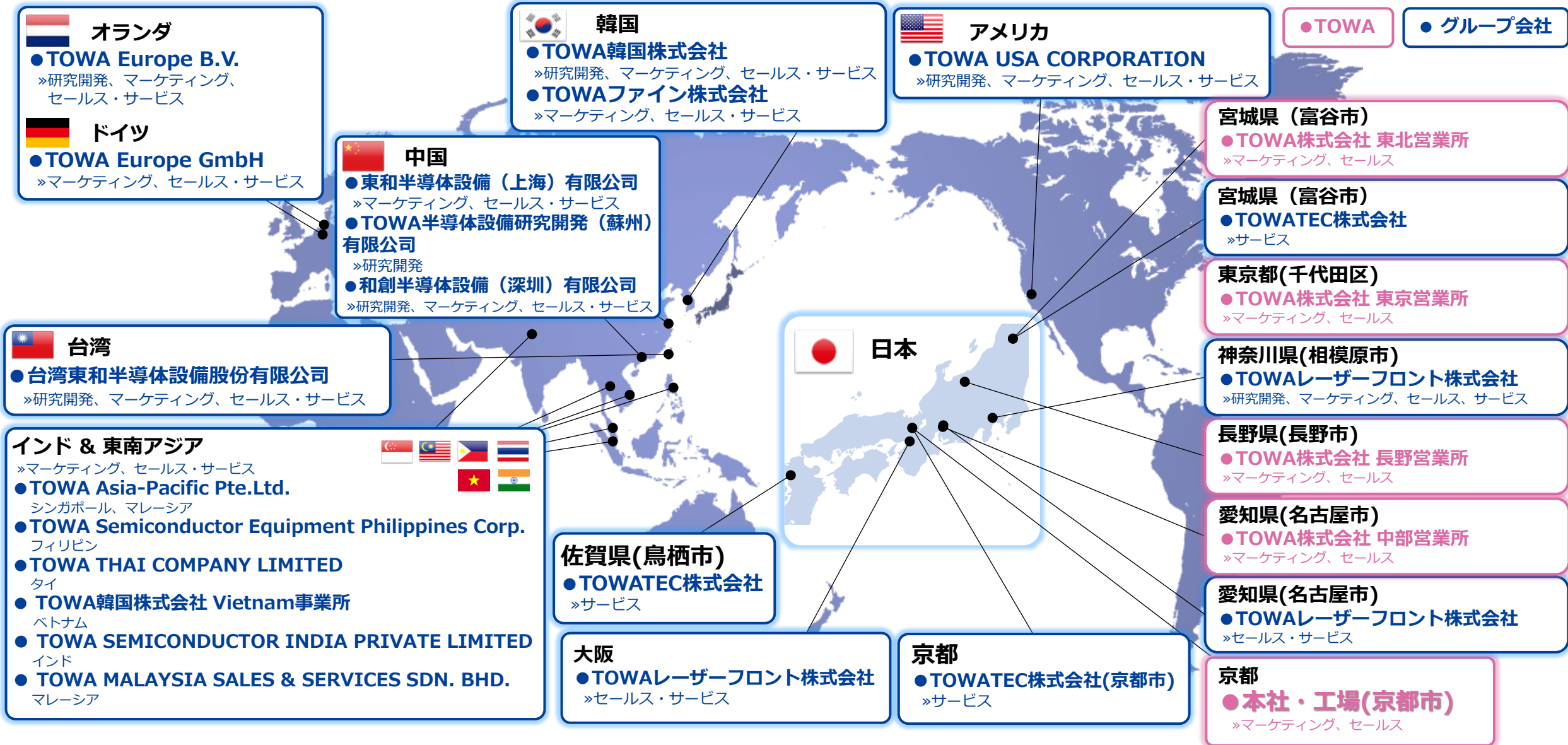


神奈川県(相模原市)

●TOWAレーザーフロント株式会社

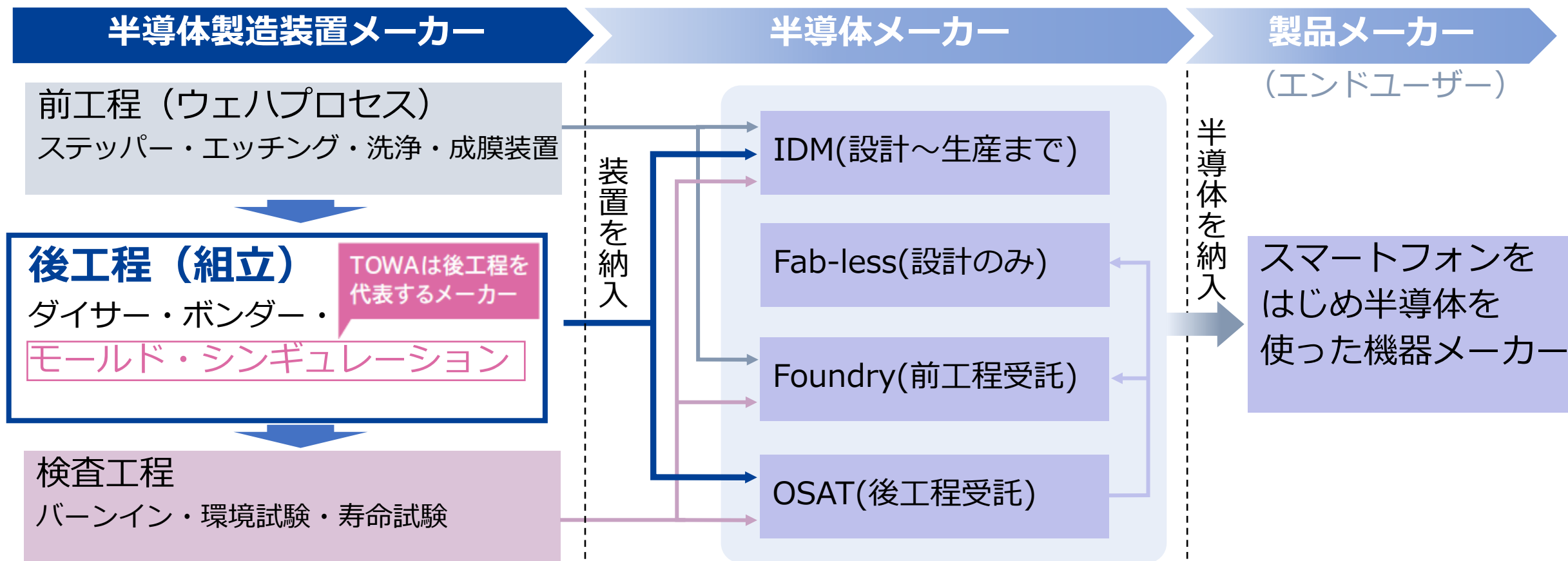
»レーザ及びレーザ加工装置の開発、製造

販売・サービス拠点



半導体製造におけるTOWAグループの立ち位置

半導体装置メーカーは、前工程・後工程・検査工程の各専用装置で住み分けされており、装置を半導体メーカーに納入します。半導体メーカーは装置メーカーの装置を使って半導体を製造し、半導体を使った製品をつくるメーカーに納入します。TOWAグループは後工程の半導体装置メーカーに属します。



半導体モールディング装置の世界シェア

64.8%

FY2024

世界シェア **No.1**

- 半導体モールディング市場のリーディングカンパニー
- 設計・生産～装置据付・量産・アフターサービスまで一貫したサポート体制
- 開発品に対しての試作環境の提供

16.0%



A社

11.7%



B社

3.3%



C社

2.4%



D社

1.8%



その他



※TechInsights社のデータをもとに当社作成

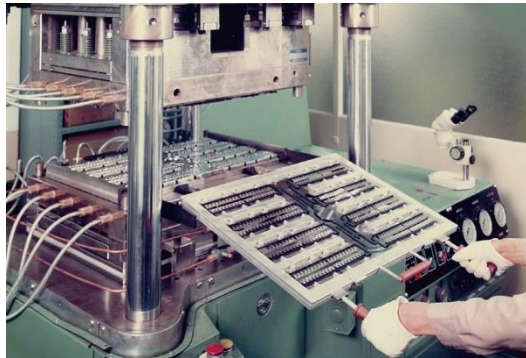
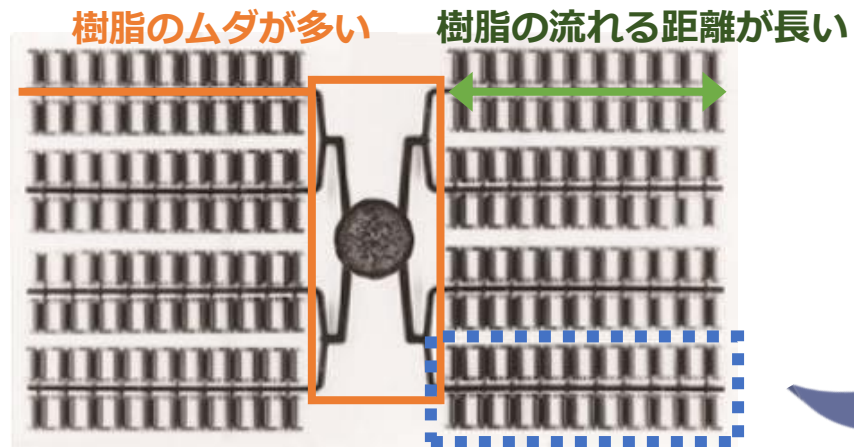


This material is the property of TOWA CORPORATION

第1次モールドディング革命(1979年)

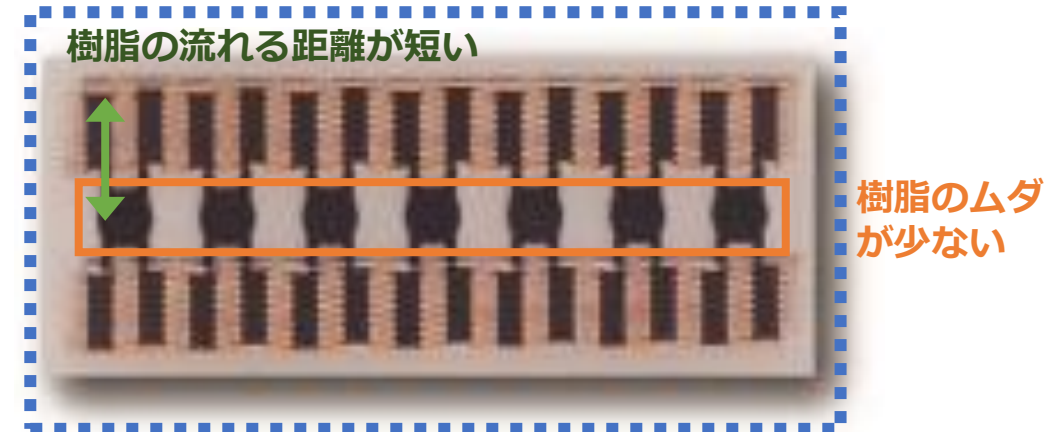
コンベンショナルモールド

手のひらサイズの樹脂を一カ所から注入し、**手動**で成形。樹脂の流れる**距離が長く成形品質にバラツキ**が出来、**樹脂のムダが多い**。



マルチプランジャモールド

指先サイズの樹脂を複数カ所から注入し、**自動**で成形。樹脂の流れる**距離が短く成形品質が向上し**、**樹脂のムダが少ない**。

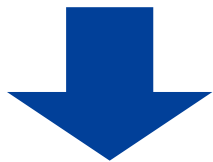


第2次モールドディング革命(1995年)

モジュールシステム (Yシリーズ)

モジュールシステム以前のモールドディング装置は・・・

- ・ 一品一様であり、生産する製品毎に装置を買い替え
- ・ 生産量に応じて複数の装置を保有する必要がある



モジュールシステムによりプレスが増減が可能に!!

- ・ Yシリーズだけで様々な製品の生産が可能
- ・ 生産量に応じて追加で設備投資が可能

後工程をIDMから組立専門企業が請け負う時代のニーズに合致!!

世界に誇る半導体モールドディング装置のベストセラー



第3次モールドディング革命(2009年)

コンプレッション装置

TOWA独自のコンプレッション（圧縮）成形方式により、最先端製品の封止と大幅なコスト削減が可能に!!

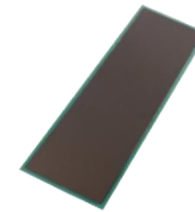
特許や技術的難易度の高さから2009年のリリース以来、現在まで**他社の追随なし。**

特 徴

- ・樹脂使用効率**100%**（**CO2排出量約70%削減**）
- ・樹脂流動のない圧縮成形（**不良品が少ない**）
- ・メモリや5G向けなどの**最先端製品**に最適
- ・顆粒/液状樹脂の両方に対応
- ・パネルサイズ、ウェハーサイズに対応



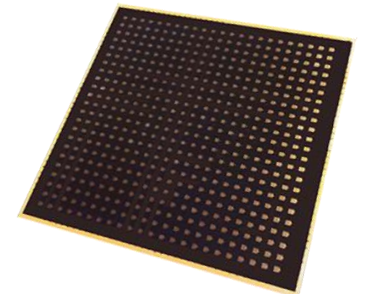
コンプレッション装置
Model PMC2030-D



基板サイズ
100×300mm



ウェハーサイズ
φ300mm



パネルサイズ
600mm×600mm

半導体製造装置ラインナップ

～Compression Mold～

コンプレッション装置
Model CPM 1180



Work max size: 660 × 620mm

コンプレッション装置
Model CPM 1080



Work max size: φ300mm、320x320mm

コンプレッション装置
Model PMC 2030-D



Work max size: 100x300mm

～ Transfer Mold～

トランスファ装置
Model YPM 1180



Work max size: 100x300mm

トランスファ装置
Model YPM1250-EPQ



Work max size: □150mm、100x300mm

～ Singulation～

シンギュレーション装置
Model FMS 4040



Work max size: 100x300mm